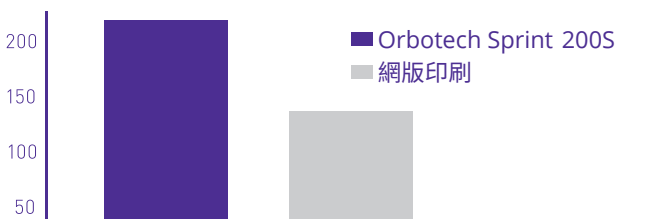


Orbotech Sprint™ 200S

適用於 PCB 噴印和序列化的高產能文字噴印系統

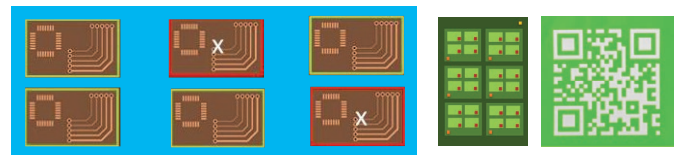
Orbotech Sprint 200S 採用 KLA 的 DotStream Pro™（專業等級墨滴涓流）技術和 MultiPrinting™（多板噴印）技術，能夠將產能提升至每小時噴印 100 多片板，系統可支援多面板、多層級序列化和多點對位，實現即時分割漲縮對位。

Orbotech Sprint 200S 為 PCB 製造商提供的解決方案能夠取代老舊、費時且對環境有害的網版印刷，同時大幅改善良率並降低總體擁有成本 (TCO)。多層級序列化 (如面板 ID、子板 ID、單位元 ID) 的功能以及領先業界的印刷品質和精確度，使 Orbotech Sprint 200S 成為序列化和可追溯性噴印解決方案的最佳選擇，同時符合工業 4.0 和中國製造 2025 的需求。



高產能—高達 6,000 面/天*
每次噴印成本達到最優化

用於產品追溯和品質控制的先進工具

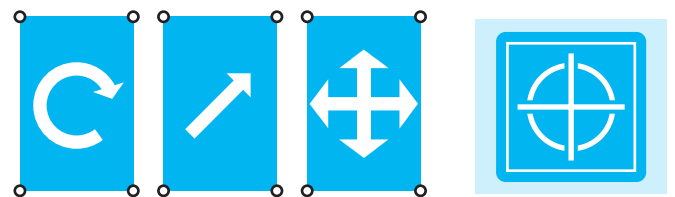


缺陷標記

序列化及二維碼



絕佳的噴印品質和高景深 (DOF)



具備全方位對位和漲縮能力的高精度噴印

高良率及成本效益

- 先進的軟板及軟硬結合板文字噴印解決方案
- 絕佳的噴印品質、高景深 (DOF) 和先進對位能力，可實現即時多靶點對位
- 複雜的二維碼噴印支持多層級序列化
- 與網版印刷相比良率更佳、總體擁有成本 (TCO) 更低

* 基於多板模式下使用 10x16 英寸板子生產超過 20 小時

獲業界認可的創新

DotStream Pro™（專業等級墨滴涓流）技術可實現：

- 更快速的絕佳噴印品質
- 更長的噴頭使用壽命
- 高階的自我維護系統

Multiprinting™（多板噴印）技術可實現

- 支持多板同時噴印，實現更高產能
- 多層級序列化 (面板、子板、單位元)
- 多重對位和分割漲縮

規格

產能*	單趟噴印模式 - 1 片板子, 24" x 18" (610 x 457mm), 最高 105 面/小時 多板模式 - 2片板子, 12" x 18" (305 x 457mm), 最高 200 面/小時 多板模式 - 3片板子, 10" x 16" (254 x 406mm), 最高 300 面/小時
最大噴印面積	30.9" x 24.4" (785mm x 620mm) 可支援多板模式 (最大噴印面積範圍內)
最小/最大板子厚度	4 - 295mils (0.1 - 7.5mm)
最低/最高解析度	720 - 1,440 dpi
最小線寬**	3mil (75µm)
最小文字高度***	12mil (0.3mm)
對位精度 (FTG)	±1.4mil (±35µm)
景深	60 mil (1.5mm)
對位	每片板子可以進行定位孔對位或 CCD 攝像機 (每片板子最多 4 個靶點) 自動即時對位
噴印模式	A-A 面或 A-B 面
噴頭	最小墨滴量 - 13 pl; 最小墨點尺寸 - 70 µm (可選: 最小墨滴量 - 6 pl; 最小墨點尺寸 - 60 µm)
噴嘴數量	2,048
軟體	軟體 RIP, Windows, Gerber RS-274X 輸入, 一按即印, 支援多種語言 適用於序列化及二維碼的先進工具
油墨類型、標準與認證****	由業界領先供應商提供的多款油墨 UL 94V-0, MIL-55110, MIL-31032, ASTM E 595, IPC-650, IPC-4781, RoHS, REACH, Halogen-free
尺寸 (寬 x 深 x 高)	63.8" x 72.8" x 63" (1620mm x 1850mm x 1600mm)
重量	3,307lbs (1,500Kg)

注意: 如果噴印面積超過 PCB 面積的 50%, Orbotech Sprint 200S 至少需用兩趟模式噴印

*多板模式下一次投放 3 片板子; 3 個靶點對位; 單趟噴印模式; 優化的噴頭清潔方法

**75 µm 線寬需用 6 pl 噴頭、特殊噴印模式和良好的防焊油墨表面張力

*** 需用 6 pl 噴頭, 建議最低使用兩趟模式

****取決於油墨配方, 如需瞭解詳情請與 KLA 聯絡

- 上述規格如有更改, 恕不另行通知

- Orbotech Sprint文字噴印系統是 1 級雷射產品。雷射規格: 符合 IEC 60825 -1 認證標準。

KLA 支持

保持系統生產力是 KLA 良率優化解決方案不可或缺的一部分。包括系統維護、全球供應鏈管理、降低成本和減少報廢、系統遷移、性能和生產率提升以及轉售認證設備。

KLA Corporation

www.orbotech.com/pcb | www.kla.com

Rev 4.0_5-06-2022

©2022 KLA Corporation 全球範圍內保留所有權利。KLA 保留無需通知而變更硬體和/或軟體規格的權利。

Orbotech 是 KLA 公司 Orbotech Limited 的註冊商標。KLA 和 KLA 標識是 KLA Corporation 的註冊商標。所有品牌或產品名稱可能是各自公司的商標。